

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023年11月14日-11月15日)

编号：2023-012

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	UG INVESTMENT ADVISERS、民生证券、中泰证券、上海证券、浙商资管、浙商基金、博道基金、百年保险资产、招商信诺资产。（排名不分先后）
活动时间	2023年11月14日-11月15日
活动地点	公司会议室（合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号）
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书 奚颢 投资者关系经理 齐博
投资者关系活动主 要内容介绍	<p>1、问：预计 Q4 毛利率水平如何，是否有环比继续提升的空间？</p> <p>答：Q4 内高阶测试平台持续进机，COF 等后道制程产能存在一定的提升空间，导致毛利率水平相对较高的部分制程产能有所增加；同时公司正持续优化产品结构，因此 Q4 单季毛利率存在环比小幅提升的可能。</p> <p>2、问：预计 2024 年度资本开支情况如何？</p> <p>答：截至目前已确定的 2024 年度资本开支主要包括可转债募投项目 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块</p>

	<p>制造与晶圆测试扩能项目及 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目，合计投资总额约 10.37 亿元（详情可参见公司已发布的可转债募集说明书及相关审核问询回复）；还包括汇成二期项目，公司拟以自有资金先行投资约 6 亿元用于新建车载显示芯片项目（详情可参见公司已发布的项目投资合作协议公告）。</p> <p>3、问：公司封测产品的终端应用分布情况如何？</p> <p>答：公司封测产品的终端应用情况系客户商业机密，客户不会告知公司所封测芯片的具体终端及品牌应用情况，公司仅能从封测产品的技术指标等方面对终端应用进行归类，2023Q3 公司封测产品中应用于智能手机的小尺寸驱动芯片占比为五成左右，高清电视、笔电、平板等中大尺寸驱动芯片占比为四成左右，其余为智能穿戴、工控等品类。</p>
附件清单（如有）	无
上传日期	2023 年 11 月 16 日